

## 性能特点

- 透明灌封胶，流动性好
- 固化速度快，工艺灵活
- 高透明度，便于元器件目视检查
- 100%固态，固化后无渗出物
- 优越的耐高低温性，极好的耐气候性，耐辐射及优越的介电性能
- 化学性能和机械性能稳定

## 产品描述

PAKCOOL® TPC-200-U1 是 10:1 双组分液态电子灌封材料，可在室温或加温固化。本产品固化后形成柔性弹性体，适合用于电气 / PCB 组件的防护等，且具有一定的可修复性。固化后胶体应力低，具有耐高低温性和绝缘性高等特点。本产品在固化前有优良的流动性和流平性，固化过程无放热，无论灌封厚度与封闭程度如何，均以恒定速率固化，固化后的胶料无挥发物生成，且本产品的固化体系具有很好的抗毒性。

## 典型应用

- LED 组装
- 高压电阻组
- 高频变压器
- 电源模块
- 传感器
- 通讯设备
- 继电器

## 注意事项

- 本产品接触有些物质可能会不固化或不完全固化，这些物质包括：硫、磷、氮的化合物如聚砜、聚硫醚、聚氨酯、含酰胺、胺的物质，含锡、砷、锑、硒、碲成分的物质及一些不饱和的碳氢化合物及增塑剂等
- 因为 A/B 组分的粘度略有差异，如采用机器灌封，需对 B 组分的压力略做调整
- 使用前需要将 A、B 组分在各自的桶内充分搅拌均匀后，再以 10:1 进行混合，并充分搅拌均匀。

## 技术参数

特性	TPC-200-U1	测试方法
基材	双组分 RTV	—
颜色	A: 无色透明 B: 无色透明	Visual
A/B 混合比例	10:1	—
粘度 (cP)	A: ≤9000 B: ≤3000	ASTM D2196-20
操作时间 (小时 @ 25°C)	>1 (可调)	—
拉伸强度 (MPa)	≥8.0	ASTM D412
硬度 (Shore A)	45±5	ASTM D2240
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.03±0.02	ASTM D792
介电强度 (kV/mm)	≥20	ASTM D149
体积电阻率 (Ω·cm)	≥1.0x10 <sup>15</sup>	ASTM D257
保质期 (@室温)	12 个月	—
连续使用温度 (°C)	-50 至+200	—

本数据仅可用于指导，并不可用于作为产品规范。

## 储存条件

- PAKCOOL® TPC-200-U1 需阴凉干燥处储藏

## 包装规格

- 500g/罐、5Kg/桶和 10Kg/桶的包装规格，并可根据客户需求定制

## 固化时间

- TPC-200-U1 硅胶在 25°C 下有很长的操作时间，其交联（完全固化）的时间将随温度升高而缩短（参见下表）。

150°C	10 分钟
70°C	60 分钟

本说明书的数据是实验室条件下获得。但因为使用环境、工艺等差异，所以不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用时，一定要先进行测试，以确认适合您使用目的的产品。如您在使用本产品中出现任何问题，欢迎和我司技术部门联系，我们将尽力为您提供帮助。